

財務概況

このセクション(財務概況)における業績は、2006年3月期の数値を示しており、比較は、2005年3月期と行っています。

なお、当社は2005年3月期より、次の会計方針の変更および事業区分の変更を行っています。

- 半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から、原則として設置完了基準に変更いたしました。
- 半導体製造装置およびFPD製造装置に係る保証期間中のアフターサービス費用については、従来の支出時の費用処理から、過去の支出実績を基準にして算出した見積額を製品保証引当金として計上する方法に変更いたしました。
- 従来の単一セグメントから、製品・サービスの種類および販売方法などの類似性を考慮して、「産業用電子機器」、「電子部品」の区分によるセグメントに変更いたしました。

売上および利益

事業環境

当期2006年3月期の世界のマクロ経済環境は、原油価格の高騰、米国での大型ハリケーン被害といった経済にマイナスインパクトを与える事象があったものの、米国および中国の経済によって牽引されながら、総じて良好なものとなりました。また、日本においては、企業の好業績を背景とした積極的な設備投資や雇用改善などが見られ、着実に景気が回復しました。

当社の参画しているエレクトロニクス業界においては、携帯型音楽プレーヤー、デジタルカメラ、DVDレコーダー、薄型テレビなどを始めとするデジタル家電製品の売上が好調に推移し、半導体需要の裾野がさらに拡大しました。また、パソコン、携帯電話についても、BRICsを始めとする新たな経済成長圏への急速な浸透が始まり、半導体需要を押し上げる要因となりました。こうした動向を背景に、半導体メーカーや液晶パネルメーカーが積極的な設備投資を行いました。

売上の状況

2006年3月期の連結売上高は、前期比6.0%増の6,737億円となりました。

地域別で見ると、半導体製造装置の売上高が日本・米国において前期を大きく上回り、韓国・台湾においても堅調に推移しました。またFPD製造装置では、台湾地域での売上が引き続き好調でした。この結果、国内売上高が12.8%増加の2,625億円、海外売上高が2.0%増加の4,112億円となり、連結売上高に占める海外売上高の比率は、前期の63.4%から61.0%に低下しました。

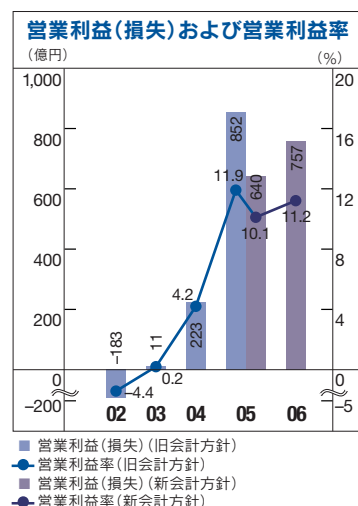
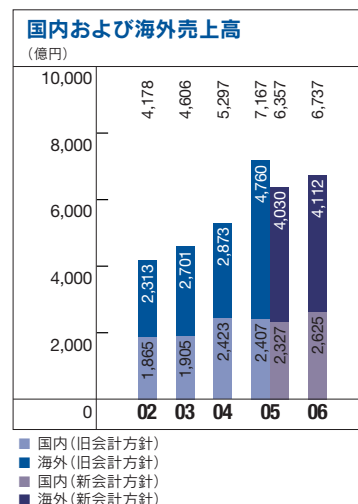
また、2006年3月期の連結受注高は7.0%増加の7,216億円、期末の受注残高は15.3%増加の3,610億円となり、いずれも過去最高となりました。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上原価は前期比5.3%増加の4,840億円、売上総利益は7.9%増加の1,897億円となり、売上総利益率は0.5ポイント改善して28.2%となりました。半導体製造装置売上の増加が改善の主な要因でした。

販売費及び一般管理費は、1.9%増加の1,140億円、売上高に対する比率は17.0%でした。一般管理費に含まれる研究開発費は492億円と12.1%増加しましたが、減価償却費や管理可能経費が減少したために、販売費及び一般管理費全体では微増に留まりました。

これらの結果、営業利益は18.3%増加の757億円、営業利益率は1.1ポイント上昇し、11.2%となりました。



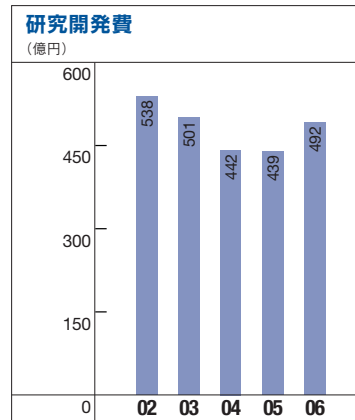
研究開発費

当期の研究開発には、前述したように、前期比12.1%増加の492億円を投じました。

製品別に見ると、半導体製造装置では、半導体デバイスの微細化への対応のみならず、さらなる高速化、低消費電力化を実現するための新材料への対応が求められており、これらに応える新技術・新製品の開発に取り組みました。当期は、こうした継続的な研究開発の成果として、6製品分野中、5つの分野で新製品を市場にリリースすることができました。FPD製造装置では、主に、大型ガラス基板対応の装置開発に取り組み、第8世代ガラス基板対応の新機種を市場に投入しました。

また、各製造装置の環境特性にあわせた環境負荷低減への取り組みも積極的に行っており、研究開発費の一部が使われています。

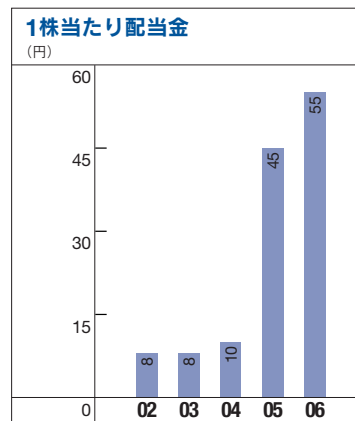
こうした既存分野における新技術・新製品の開発のみならず、コア技術をベースにした新規事業創出のための開発投資も行いました。



その他収益(費用)および当期純利益

前期は、過年度の収益に対応する製品保証引当金125億円を特別損失として計上したことなどにより、その他の費用純額は82億円でしたが、当期は大きな特別利益および特別損失が発生しなかったために、その他の費用純額は4億円に留まりました。この結果、税金等調整前当期純利益は、35.1%増加の753億円となりました。

当期純利益は480億円でした。前期には繰延税金資産の再計上279億円が大きな増益効果となりましたが、当期はその反動で、前期比で22.1%の減少となりました。また、1株当たり当期純利益は267.61円(前期1株当たり当期純利益343.63円)となりました。



配当政策および当期配当金

当社は、業績連動型・収益対応型の配当を行うことを株主還元の基本方針としています。当期より、連結当期純利益に対する配当性向20%を目途とすることを新しい配当政策とし、配当を実施していきます。当期の1株当たり配当金は前期比10円増加の55円、配当性向は連結ベースで20.6%となりました。

	2002年3月期	2003年3月期	2004年3月期	2005年3月期	2006年3月期
売上高	¥417,825	¥460,580	¥529,654	¥635,710	¥673,686
売上総利益	115,555	134,040	140,155	175,913	189,732
売上総利益率	27.7%	29.1%	26.5%	27.7%	28.2%
販売費及び一般管理費	133,865	132,921	117,875	111,930	114,029
営業利益(損失)	(18,310)	1,119	22,280	63,983	75,703
営業利益率	(4.4)%	0.2%	4.2%	10.1%	11.2%
税金等調整前当期純利益(損失)	(22,919)	(23,010)	14,936	55,775	75,328
当期純利益(損失)	(19,938)	(41,554)	8,297	61,601	48,006

2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくは連結財務諸表注記をご参照ください。

セグメント別の状況

産業用電子機器事業

主力の半導体製造装置の売上高が好調だったことにより、当セグメントの2006年3月期における売上高(他のセグメントへの内部売上を含む)は、前期比6.8%増加の5,878億円となりました。営業利益は19.4%増加の726億円、営業利益率は1.3ポイント上昇し、12.3%となりました。

■ 半導体製造装置

当事業の外部顧客への売上高は、6.5%増加の4,869億円となりました。

携帯型音楽プレーヤー、カーエレクトロニクス製品の急伸に加え、年度初めにはやや慎重な見方もあったパソコン・携帯電話の出荷も順調に伸び、これらの電子機器に搭載されるNAND型フラッシュメモリ、DRAMなどの半導体需要が好調に推移しました。こうした動向を受け、半導体メーカーが生産能力強化と最先端デバイス開発に向けた設備投資を積極的に行ったため、当社製品に対する引き合いが活発化しました。

製品群では、アジアを中心とした半導体メモリメーカーによる力強い設備投資意欲を背景に、エッチング装置、熱処理成膜装置、CVD装置、サーフェスプレパレーションシステムの売上が増加しました。製品モデル別では、次世代の微細化技術に対応するコータ/デベロップCLEAN TRACK™ LITHIUS™、新型オートウエットステーションEXPEDIUS、また最新型のエッチングチャンバー SCCM™-JIを搭載した酸化膜エッチング装置Telius™、などの販売が拡大しました。

ウェーハ口径別では、300mmウェーハ対応装置売上が85%、200mmウェーハ対応装置売上が15%となりました。

当事業の通期受注高は2.1%減少の4,999億円、期末の受注残高は5.5%増加の2,492億円となりました。

■ FPD製造装置

当事業の外部顧客への売上高は、8.2%増加の812億円となりました。

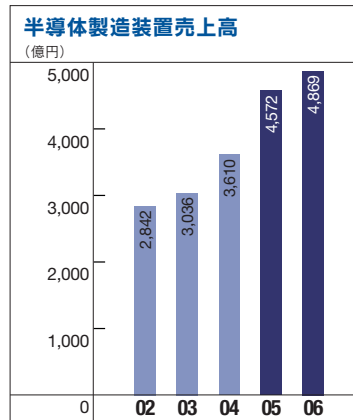
デジタル放送、ハイビジョン放送への移行に伴い、液晶テレビなどの大画面薄型テレビが一般家庭に急速に普及してきており、液晶パネルメーカーは、生産能力強化と最先端ディスプレイパネル開発のための設備投資を増強しました。このような環境のもと、特に台湾地域における売上が拡大しました。世代別には、第6世代ガラス基板対応装置が売上に大きく貢献し、第7世代ガラス基板対応装置も売上が急伸しました。

当事業の通期受注高は、82.2%増加の1,135億円、期末の受注残高は、48.4%増加の991億円となりました。

■ コンピュータ・ネットワーク

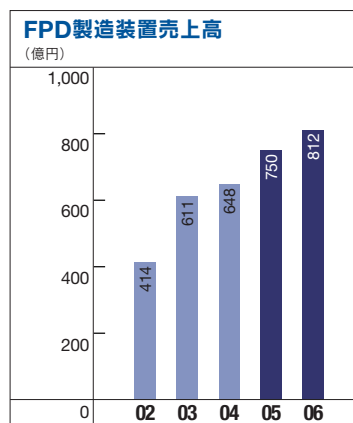
当事業の外部顧客への売上高は、9.6%増加の175億円となりました。

売上高の40%を占めるSAN(Storage Area Network)関連製品では、ネットワーク構築の基盤技術であるファイバーチャネルスイッチ、ホストバスアダプタビジネスの売上が堅調に推移しました。ネットワーク関連製品では、安全性の高いWebサイト構築を可能にする製品を中心にサイト構築ビジネスが堅調に推移し、これに伴うサポートおよび保守の売上も増加しました。



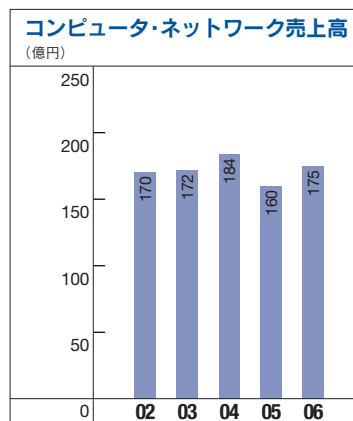
■ 旧会計方針
■ 新会計方針

2005年3月期より、従来、半導体製造装置部門売上高に含めていたFPD製造装置の売上を、半導体製造装置部門売上高から分離して開示しています。本グラフ上の2004年3月期以前の半導体製造装置売上高は、読者の利便性を考慮し、単独ベースでのFPD製造装置売上を差し引いた数字で示しています。(数字：監査対象外)



■ 旧会計方針
■ 新会計方針

2005年3月期より、従来、半導体製造装置部門売上高に含めていたFPD製造装置の売上を、半導体製造装置部門売上高から分離して開示しています。本グラフ上の2004年3月期以前のFPD製造装置売上は単独ベース、2005年3月期より連結ベースで示しています。



当事業の通期受注高は、13.5%増加の187億円となり、期末の受注残高は28.7%増加の53億円となりました。

尚、当コンピュータ・ネットワーク部門の航空宇宙関連製品ビジネスを除いた全ての事業が、2006年10月1日に、会社分割により東京エレクトロンデバイス株式会社に承継される予定です。

■ その他

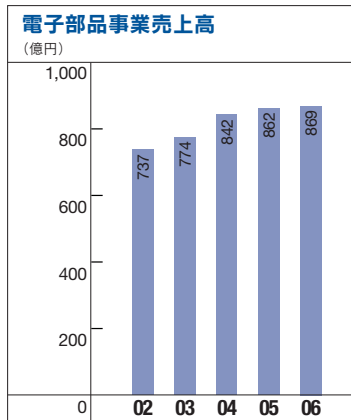
その他の売上は、主に、保険業務、旅行業務等の内部サービス関連業務の売上です。売上高は、1.4%減少の12億円となりました。

電子部品事業(東京エレクトロンデバイス株式会社)

当セグメントの2006年3月期の売上高(他のセグメントへの内部売上を含む)は、前期比0.2%増加の883億円となりました。営業利益は前期と同等の31億円、営業利益率は3.5%でした。また、外部顧客への売上高は0.7%増加の869億円でした。

製品群別売上構成比は、「半導体製品」88.6%「ボード製品」4.7%「ソフトウェア」3.6%「一般電子部品」3.1%でした。売上全体のほぼ9割を占める「半導体製品」においては、設備投資の増加を背景にして、ファクトリー・オートメーション関連装置や携帯電話基地局向けの製品が堅調でした。また、個人消費の拡大を背景にして、薄型テレビやカーナビゲーションシステム向け製品の売上も堅調でした。

当事業では、新規顧客の開拓に努め、カスタムICや汎用IC(アナログIC)など、高度な技術サポートを要する高付加価値商品の販売に注力しています。また、半導体の設計受託業務の拡大を図り、自社ブランド商品「inrevium(インレピウム)」のマーケティングを推進するなど、開発ビジネスの強化に努めています。



上記グラフは外部顧客への売上高を示しています。

	(百万円)				
2006年3月期	産業用 電子機器	電子部品	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業利益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	¥586,805	¥86,881	¥673,686	¥ -	¥673,686
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,004	1,409	2,413	(2,413)	-
合計	587,809	88,290	676,099	(2,413)	673,686
営業費用	515,241	85,190	600,431	(2,448)	597,983
営業利益	72,568	3,100	75,668	35	75,703
資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	¥626,838	¥37,089	¥663,927	¥ (684)	¥663,243
減価償却費	20,512	258	20,770	-	20,770
固定資産の減損損失	419	-	419	-	419
資本的支出(無形固定資産及びその他資産への支出を含む)	16,223	144	16,367	-	16,367

財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債および資本

2006年3月期末の総資産は、前期末から189億円増加の6,632億円となりました。

流動資産では、現金及び預金の増加246億円、受取手形及び売掛金の減少35億円、たな卸資産の増加23億円などにより223億円増加し、5,175億円となりました。また、資産回転日数の短縮に取り組んだ結果、受取手形及び売掛金(未収金を除く)の回転日数が99日から92日に、また、たな卸資産回転日数が93日から89日に改善しました。

有形固定資産は、主に設備投資の減価償却が進んだことにより、37億円減少の947億円となりました。

投資その他資産は、株式市況の回復による評価益などにより投資有価証券が45億円増加しましたが、繰延税金資産、無形固定資産が減少したことにより、全体では3億円増加の510億円となりました。

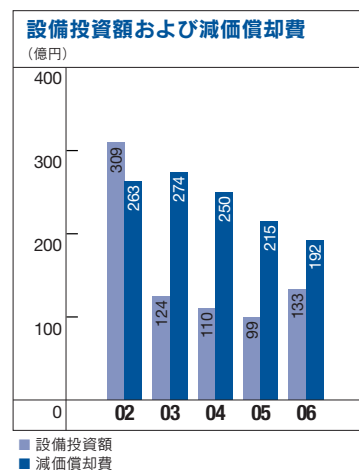
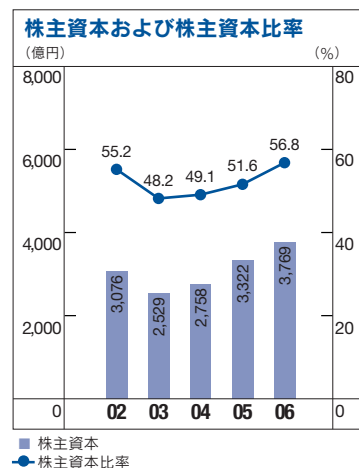
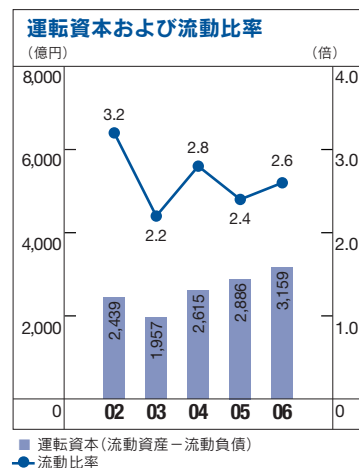
総負債は、261億円減少の2,816億円となりました。

前期に引き続き有利子負債の低減に取り組んだ結果、短期借入金、1年以内償還予定長期借入金及び社債、長期借入金及び社債を合わせた有利子負債が、普通社債300億円の減少、銀行借入金43億円の減少により344億円減少して651億円となりました。これにより、デット・エクイティ・レシオは前期末の29.9%から17.3%に改善しました。

株主資本は、好業績の結果、利益剰余金が前期末比378億円増加したことを主な要因に、447億円増加の3,769億円となりました。これにより、株主資本比率は5.2ポイント増加の56.8%、株主資本当期純利益率(ROE)は6.8ポイント減少の13.5%となりました。

設備投資額および減価償却費

設備投資額は、前期比35.0%増加の133億円となりました。設備投資の主な内容は、半導体製造装置およびFPD製造装置の研究開発用の評価機・測定機の取得、およびIT関連投資でした。減価償却費は、10.7%減少の192億円でした。



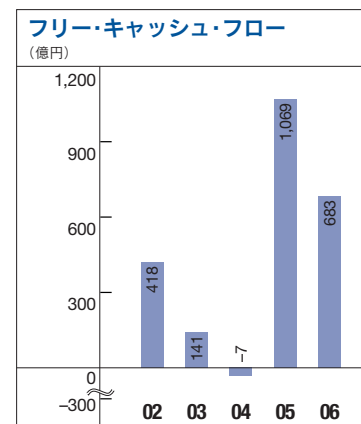
キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比355億円減少の789億円のプラスとなりました。主な内容としては、税金等調整前当期純利益753億円、減価償却費192億円、受取手形及び売掛金の減少51億円、支払手形及び買掛金債務の増加67億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなった一方、前受金の減少95億円、法人税等の支払額195億円がキャッシュ・フローのマイナスとなったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比31億円減少のマイナス105億円となりました。主な内容は、研究開発用の評価機・測定機等の有形固定資産の取得による86億円の支出です。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比91億円減少のマイナス434億円となりました。主な内容は、第9回無担保社債300億円の償還、長期借入金の返済55億円、配当金の支払い98億円です。

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、246億円増加の1,400億円となりました。



フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

事業などのリスク

当社の経営成績、財務状況および当社株価などに影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1) 外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっています。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としていますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約などによって為替リスクヘッジに努めています。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社の業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術などの最先端技術について積極的な研究開発投資および研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれなどの影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置などのハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加などの発生により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品および顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理などの各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しています。しかしながら、当社製品に関連する安全性などの問題により、顧客への損害発生、受注取消などが発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、およびレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用して頂くことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品であるなどの原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生するなどにより当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略および知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や知的財産権を回避する場合などがあるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業におけるさらなる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社および他業種企業と同様に、世界および各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症などの不可抗力、金融・株式市場、政府などによる規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失などの影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。